

2025年3月期

第1四半期 決算説明

2024年8月8日

芝浦メカトロニクス株式会社

業績サマリー

■ 売上高・利益

➤ 前年比 増収増益

売上高 171億円 (SPE比率 74%) 20%増収
半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加

■ 業績予想

➤ 通期業績予想、年間配当予想を上方修正

売上高 730億円、営業利益 118億円、ROS 16.2%、配当 235円

■ 受注高

➤ 半導体前・後工程とも回復 213億円

前年比 21%増加、前4Q比 40%増加

➤ 半導体前工程は、顧客拡大に伴い、ロジック/ファウンドリ向け枚葉式リン酸エッチング装置が増加

半導体後工程は、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調

業績結果 (対前年)

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

(単位 : 億円)

	2023				2024 1Q	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	143	162	174	197	171	+20%
営業利益	21.3	28.9	30.9	35.8	30.7	+44%
ROS	14.9%	17.8%	17.8%	18.2%	17.9%	+3.0pt
経常利益	22.1	28.2	29.7	36.1	31.4	+42%
当期純利益	18.0	20.7	21.8	27.4	22.9	+28%
受注高	177	156	133	152	213	+21%

■ 売上高

前年比20%増収 (143億円 ⇒ 171億円)

- SPE分野が増加、FPD分野は前年同等、流通機器分野が改刷特需により増加。

■ 営業利益

前年比44%増益 (21.3億円 ⇒ 30.7億円)

- SPE分野、流通機器分野の売上増加により増益。

■ 受注高

前年比21%増加 (177億円 ⇒ 213億円)

- 半導体前工程のロジック/ファウンドリ向け装置、後工程の生成AI用GPU用途を含む先端パッケージ向け装置が好調に推移。
流通機器分野が改刷特需により増加。

セグメント別業績結果 (対前年) ①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比5%減 (112億円 ⇒ 106億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け装置は順調に推移したが、シリコンウェーハ向け装置が前年度受注減少の影響を受け低調となり減少。

FPD前工程では、低調で前年同等。

➤ セグメント利益 前年比12%減 (21.5億円 ⇒ 18.9億円)

半導体前工程の売上減少により減益。

➤ 受注高 前年比21%増 (115億円 ⇒ 139億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け装置が好調に推移。

FPD前工程では、市況の影響を受け低調に推移。

セグメント別業績結果 (対前年) ②

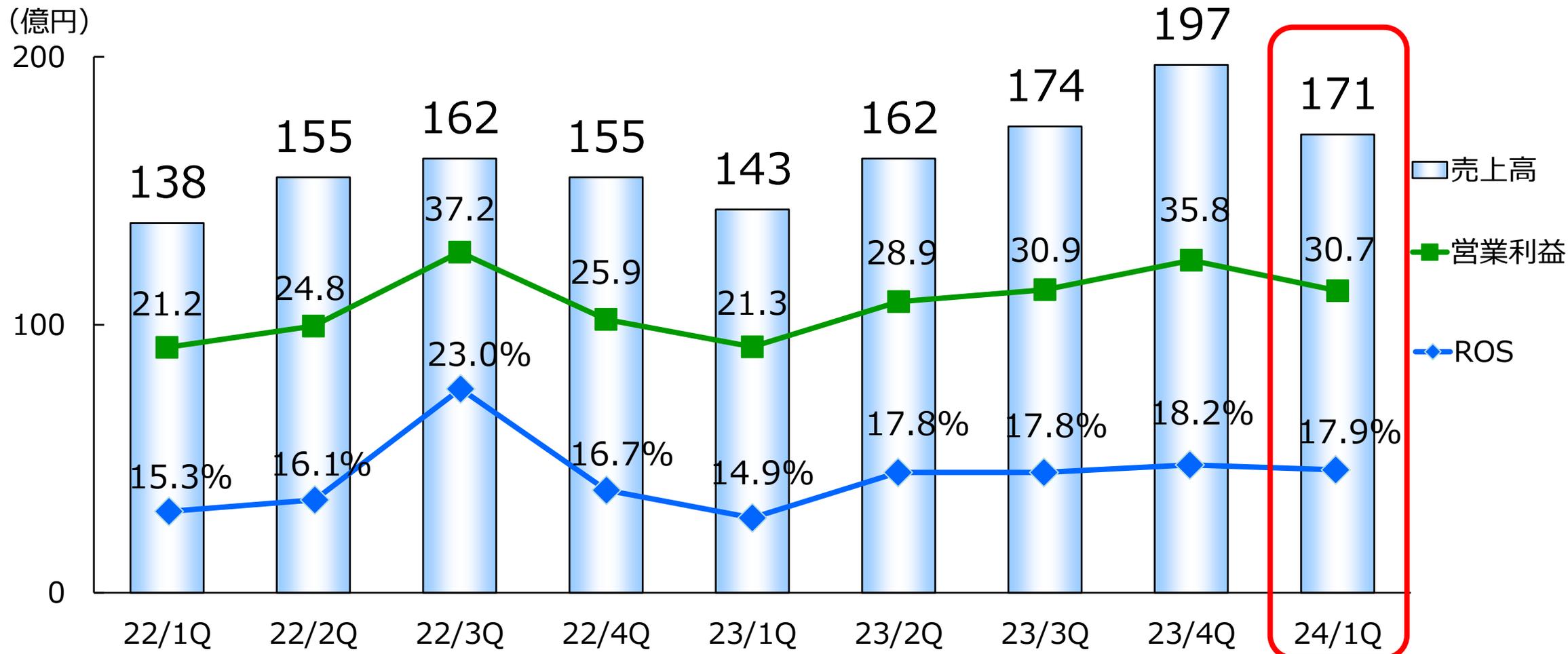
■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- **売上高** 前年比119%増 (21億円 ⇒ 45億円)
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調で大幅に増加。
FPD後工程では、低調で前年同等。
真空応用装置では、半導体分野向けが堅調で増加。
- **セグメント利益** 8.3億円 (前年0.4億円)
半導体後工程及び真空応用装置の売上増加により大幅増益。
- **受注高** 前年比5%増 (50億円 ⇒ 53億円)
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。
FPD後工程及び真空応用装置では、市況の影響を受け低調に推移。

売上高・利益・ROS

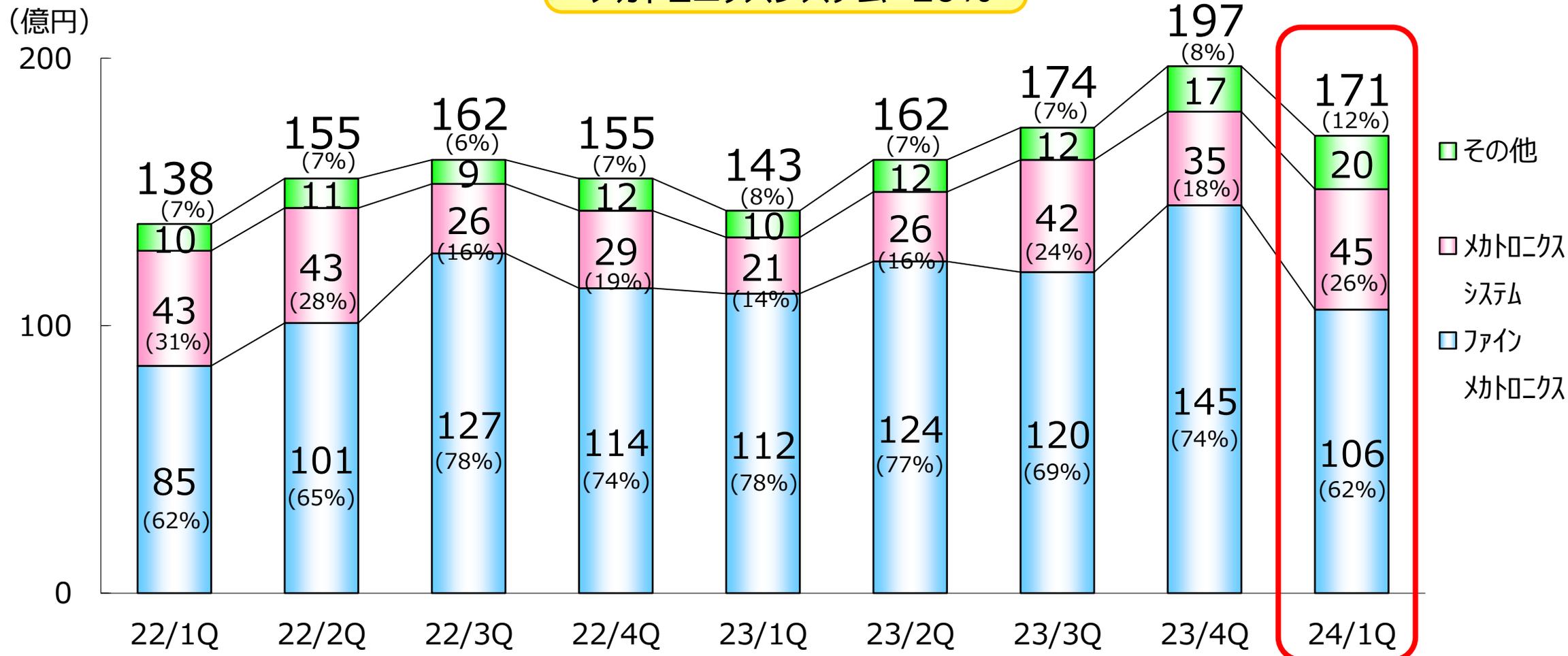
ROS17.9%



セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 62%
メカトロニクスシステム 26%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

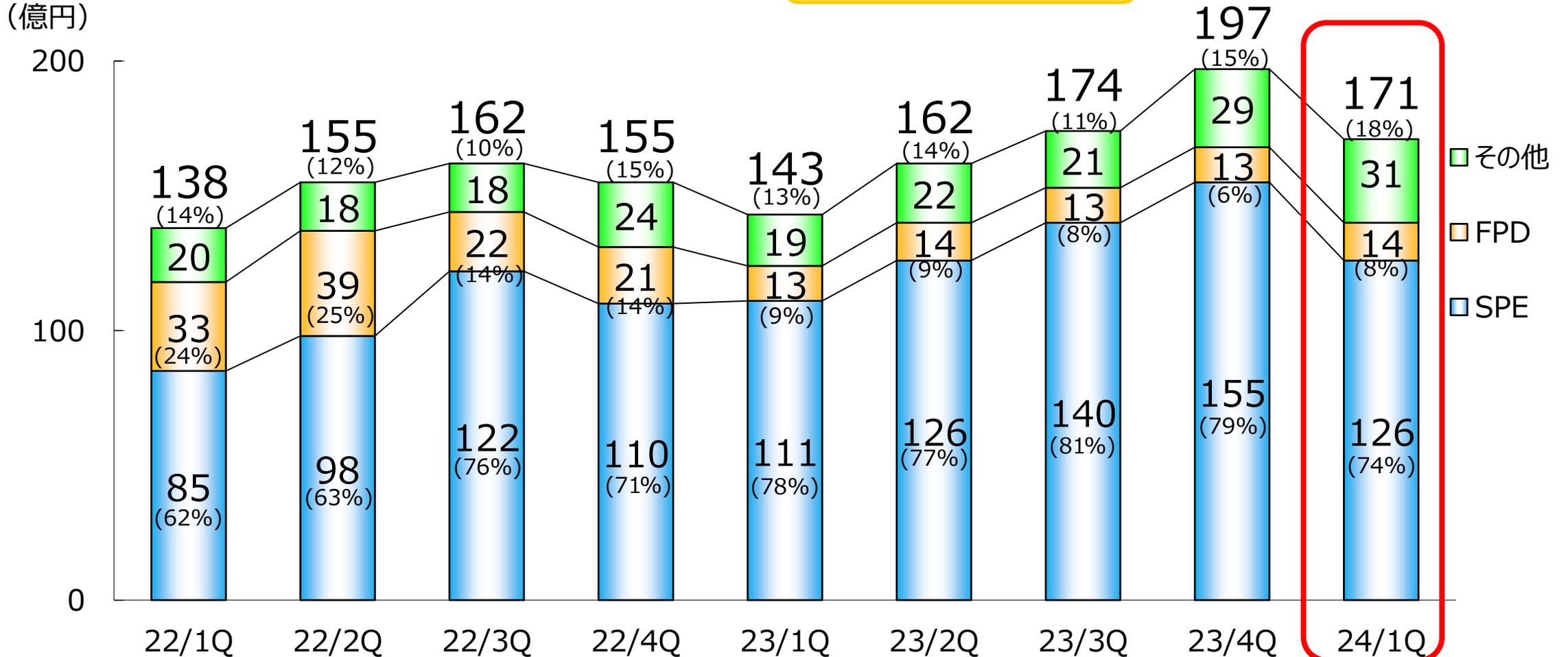


分野別売上高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

SPE分野 74%

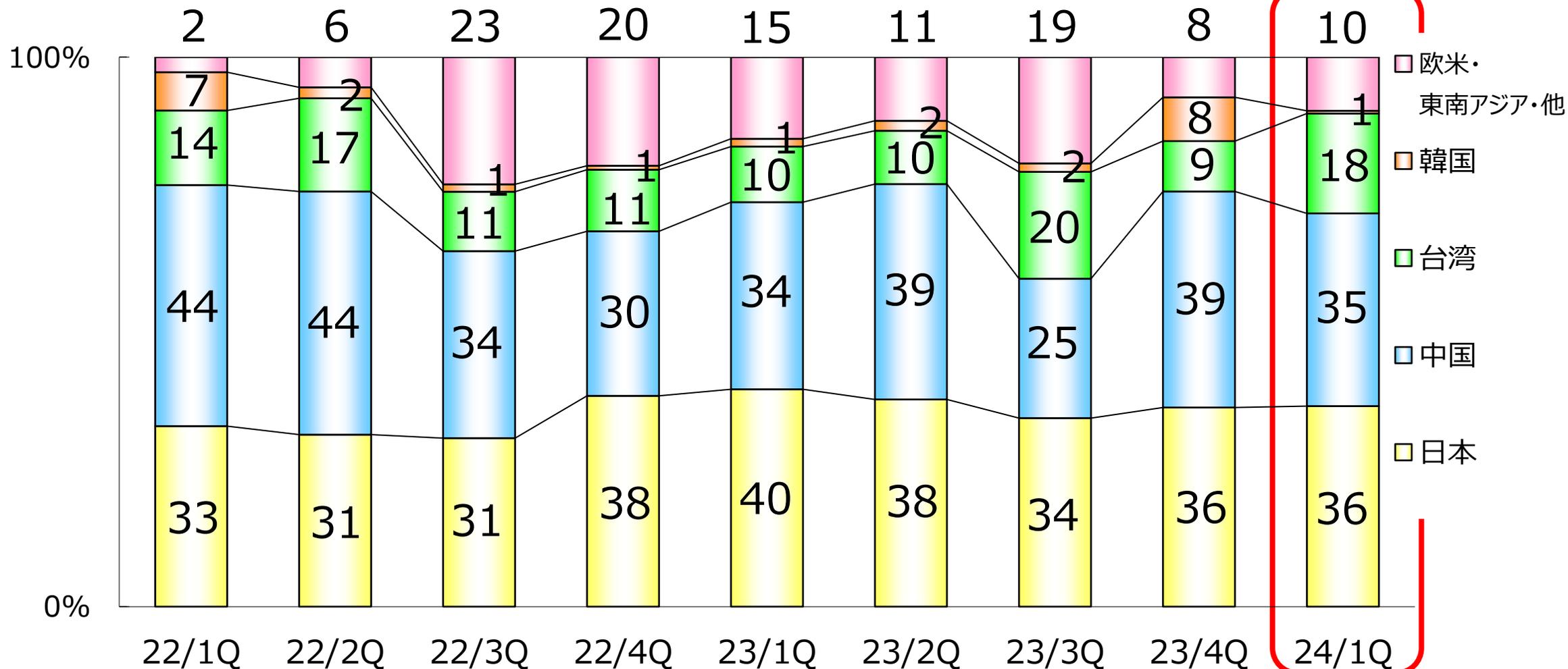
(億円)



地域別売上高比率

海外向け64% (中国35%)

* 仕向地で区分

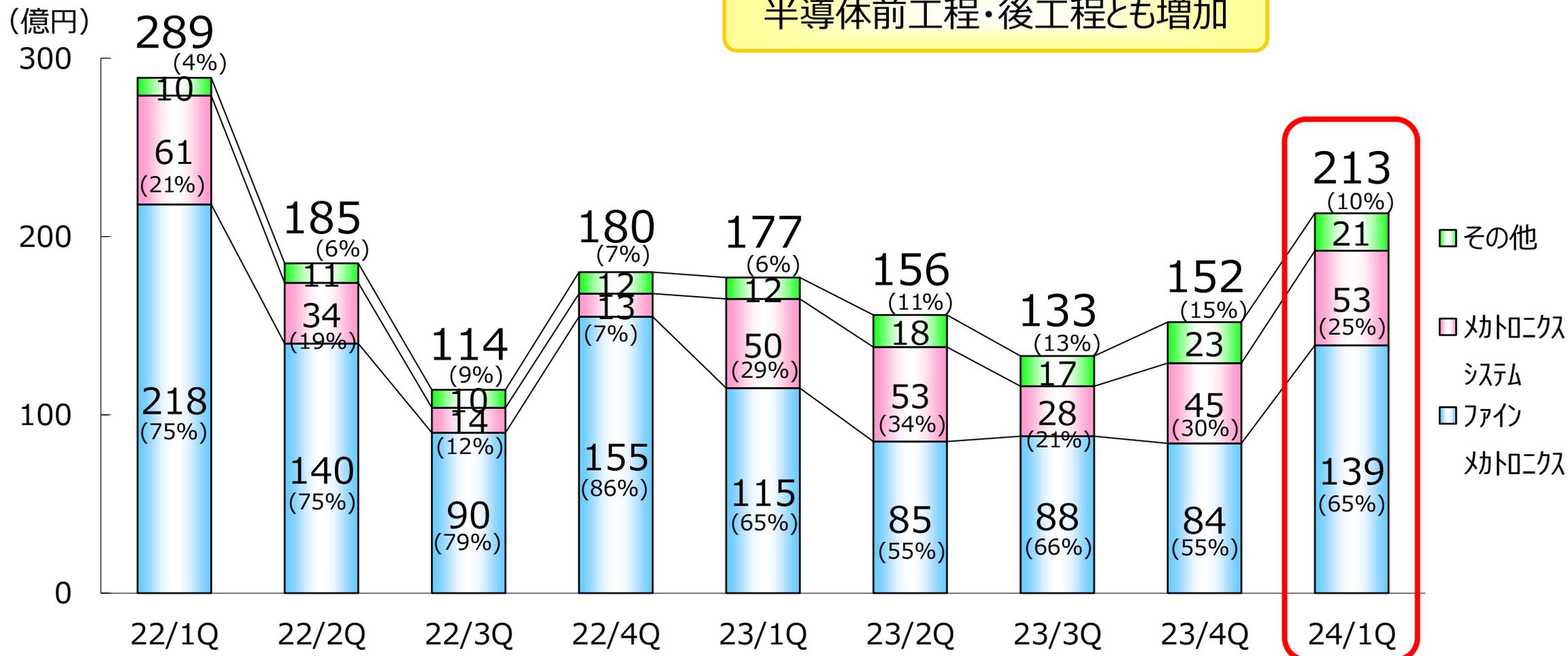


セグメント別受注高

* ファインメカトロクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

半導体前工程・後工程とも増加

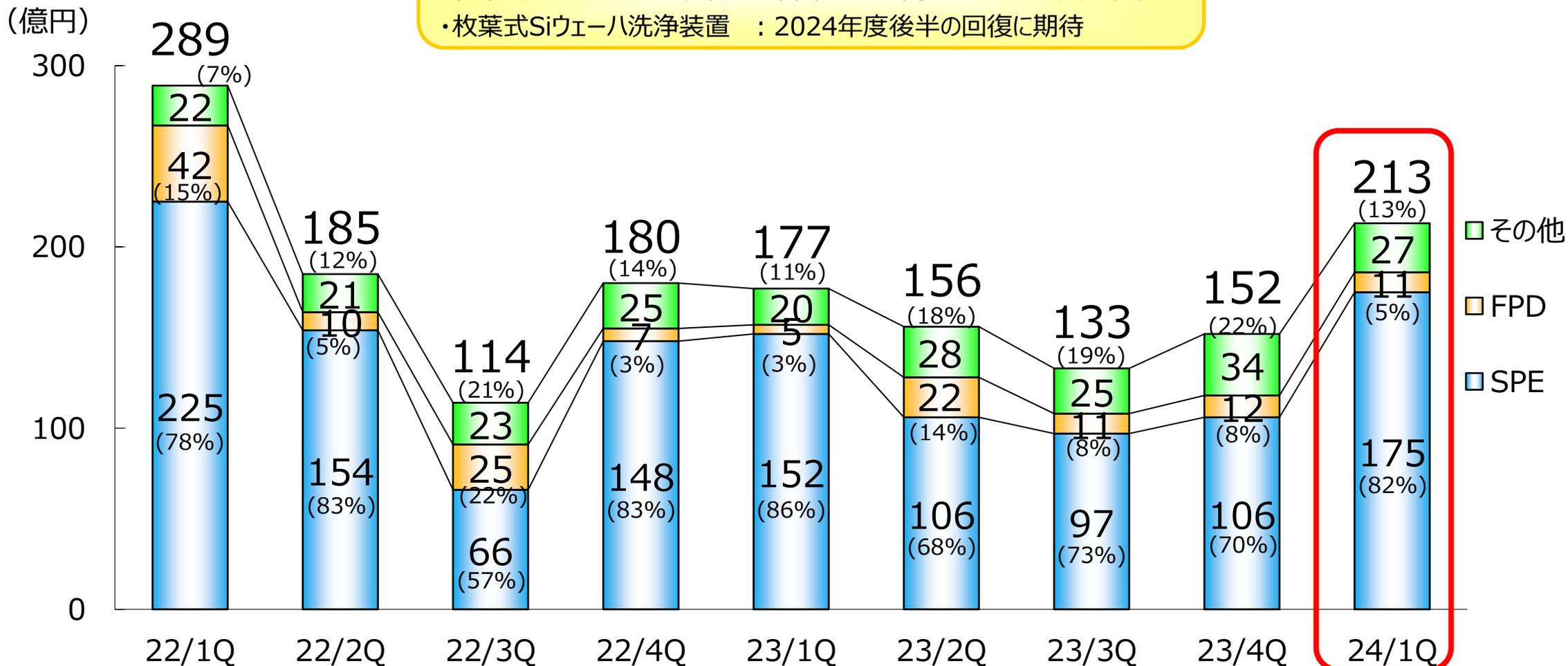


分野別受注高

今後に向けての受注見通し

- ・先端パッケージ向け装置 : 生成AI用GPUの需要増で受注好調
- ・枚葉式リン酸エッチング装置 : 中国レガシー向けの引合い、受注継続
- ・枚葉式Siウエーハ洗浄装置 : 2024年度後半の回復に期待

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

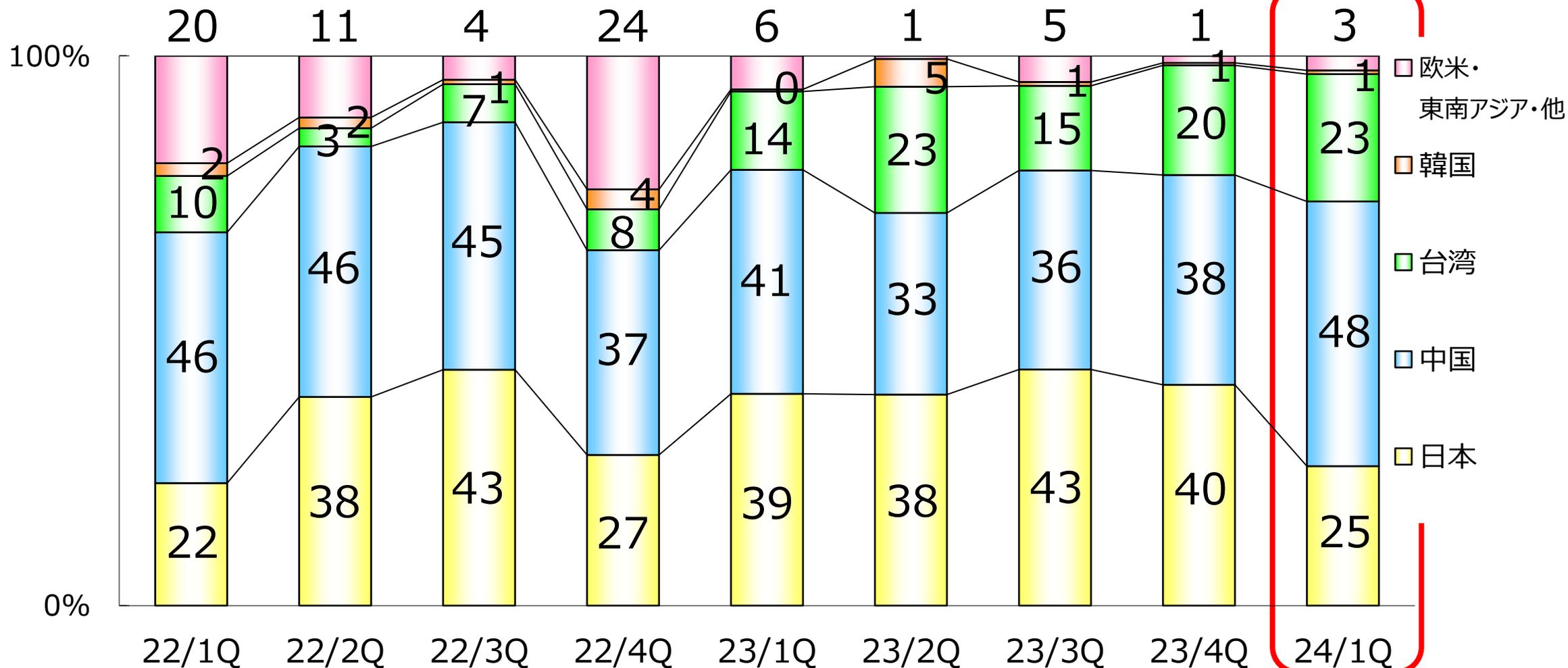


2024/1Q 実績 (10)

地域別受注高比率

海外向け75%
(中国48%、枚葉式リン酸エッチング装置増加)

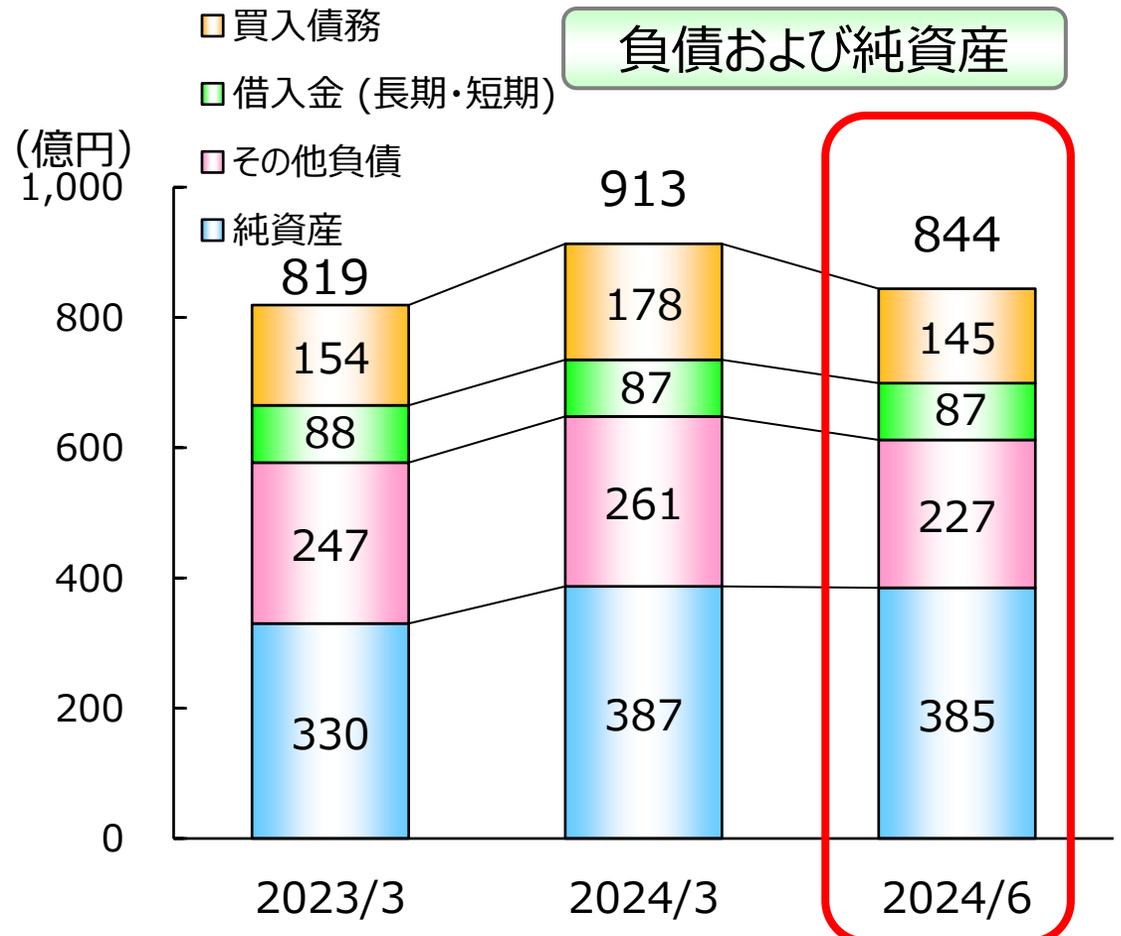
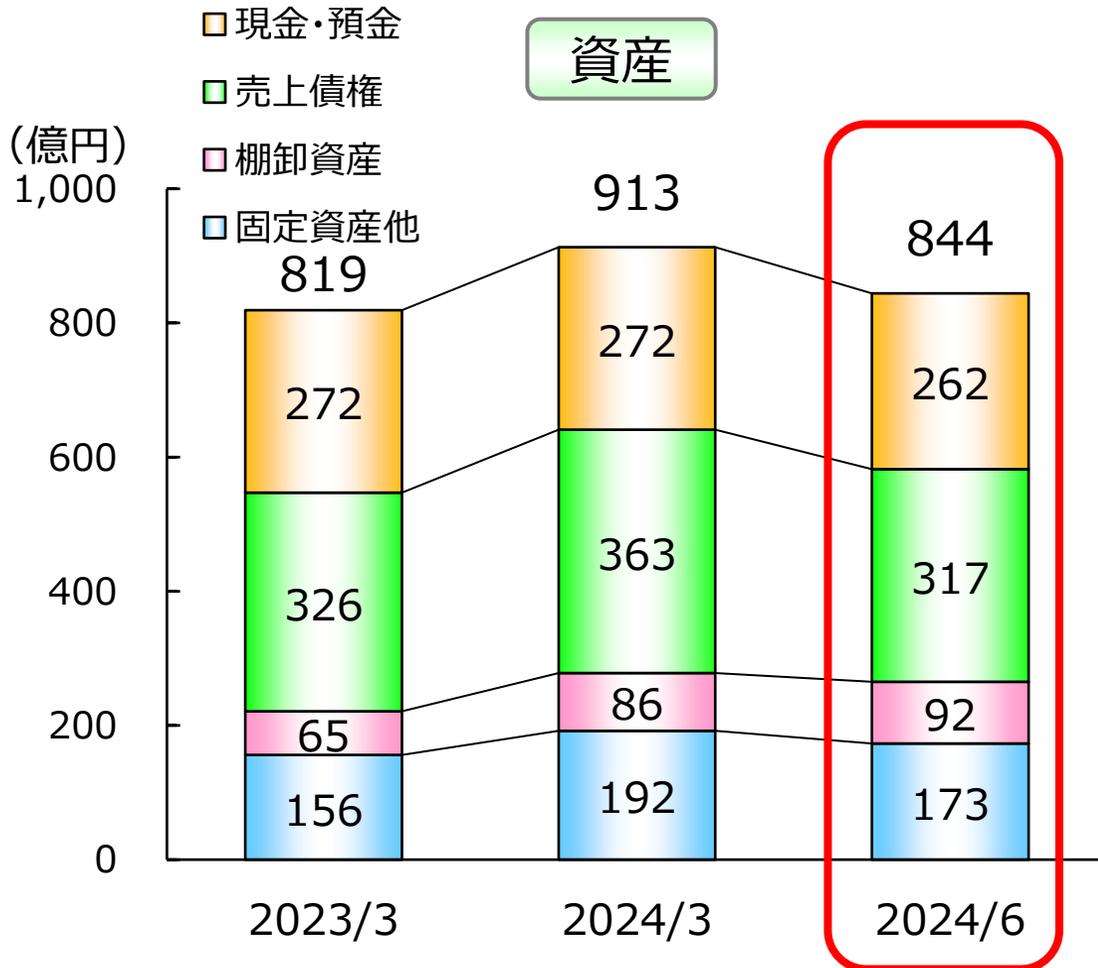
* 仕向地で区分



2024/1Q 実績 (11)

貸借対照表

自己資本比率 42% ('24/3) → 46% ('24/6)
 D/Eレシオ 0.23倍 ('24/3) → 0.23倍 ('24/6)



2024年度 業績予想 (1)

業績予想

業績進捗及び足もとの顧客の投資動向等を踏まえ
2024年度予想を上方修正

*1: 2024年5月公表
24/上、24/下見通しはご参考

(単位: 億円)

	2021 年度	2022 年度	2023		2023 年度	2024		2024 年度 予想	前回予想 *1		2024 年度
			23/上	23/下		24/上 見通し	24/下 見通し		24/上 見通し	24/下 見通し	
売上高	493	610	305	371	676	343	387	730	313	387	700
営業利益	50.5	109.1	50.2	66.7	116.9	51.4	66.6	118.0	33.4	66.6	100.0
R O S	10.3%	17.9%	16.4%	18.0%	17.3%	15.0%	17.2%	16.2%	10.7%	17.2%	14.3%
経常利益	48.8	105.1	50.3	65.8	116.1	51.3	65.7	117.0	30.8	65.2	96.0
当期純利益	29.8	92.0	38.7	49.2	87.9	38.3	49.7	88.0	23.0	49.0	72.0
R O E	12.8%	31.9%	-	-	24.5%	-	-	21.0%	-	-	17.6%
F C F	77.9	32.0	46.3	-9.7	36.8	-	-	6.0	-	-	6.0

配当予想

当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。
 2024年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は前回予想
 から42円増配の235円（配当性向 35.0%）を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想（2025年3月期）	0円	235円	235円
前回予想（2025年3月期）	0円	193円	193円

（ご参考）2024年3月期 年間配当200円

SPE

* GNT : 現中期経営計画
グローバル ニッチトップ
対象製品群

- グローバルニッチトップ対象製品群の売上堅調
SPE売上高 126億円の内、GNT 84億円（67%）で推移
- 先端パッケージ向け装置は、生成AI用GPU用途中心に引き続き受注好調
- 枚葉式リン酸エッチング装置は、中国市場での引合い、受注が継続中
- 枚葉式Siウェーハ洗浄装置は、一定の引合い継続中、年度後半の回復に期待
- マスク洗浄装置は、凍結洗浄機能搭載の新製品をフィールド評価中

FPD

- LCDパネル向けは前・後工程とも、依然として設備投資が低水準
- OLEDパネル向け投資の回復に期待、マイクロOLED、マイクロLED市場に向けても注力

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

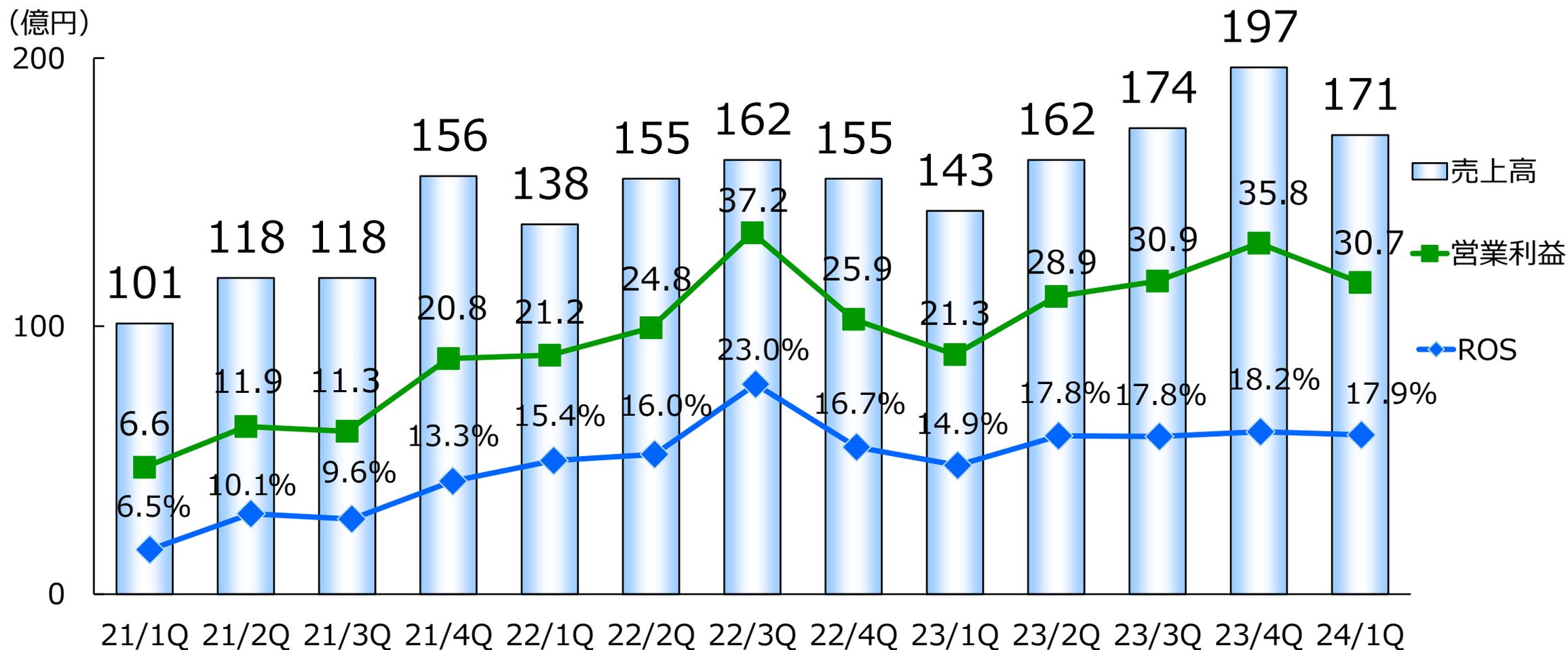
「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END

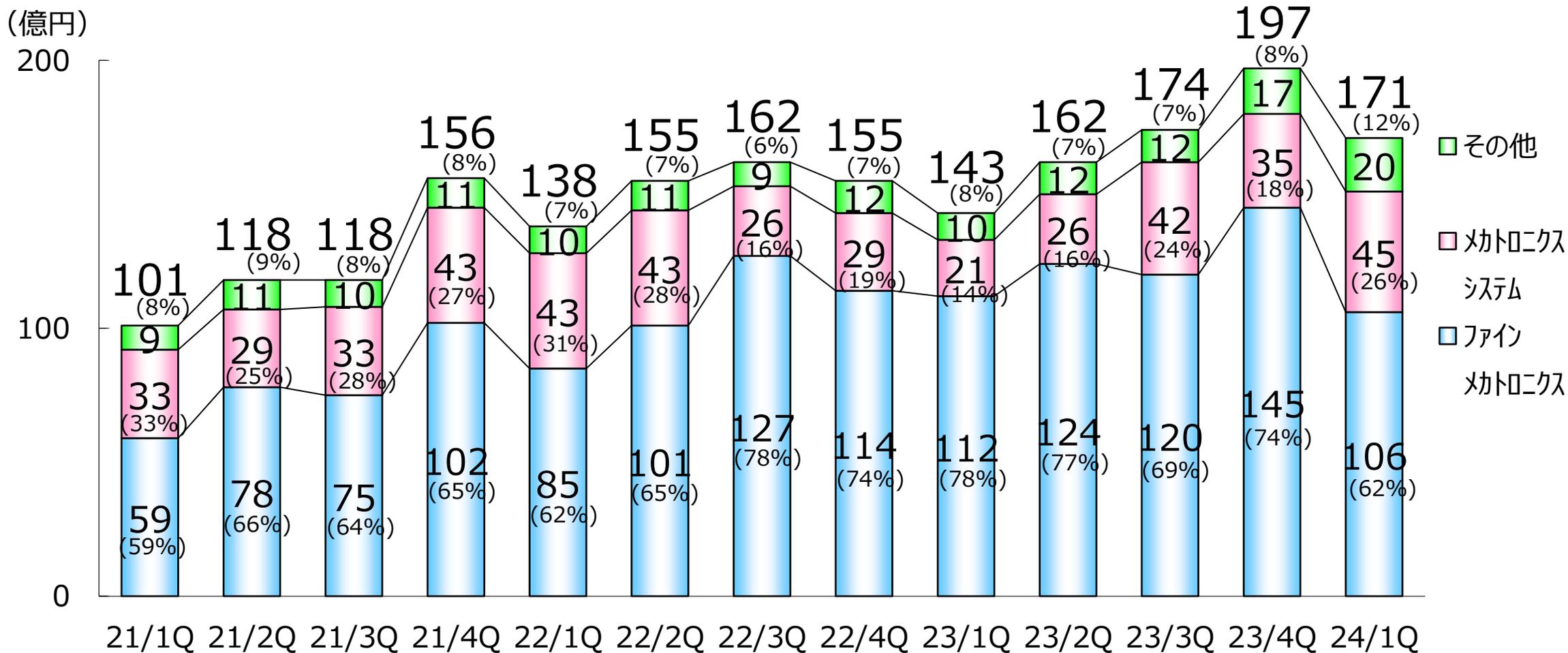
Appendix

売上高・利益・ROS



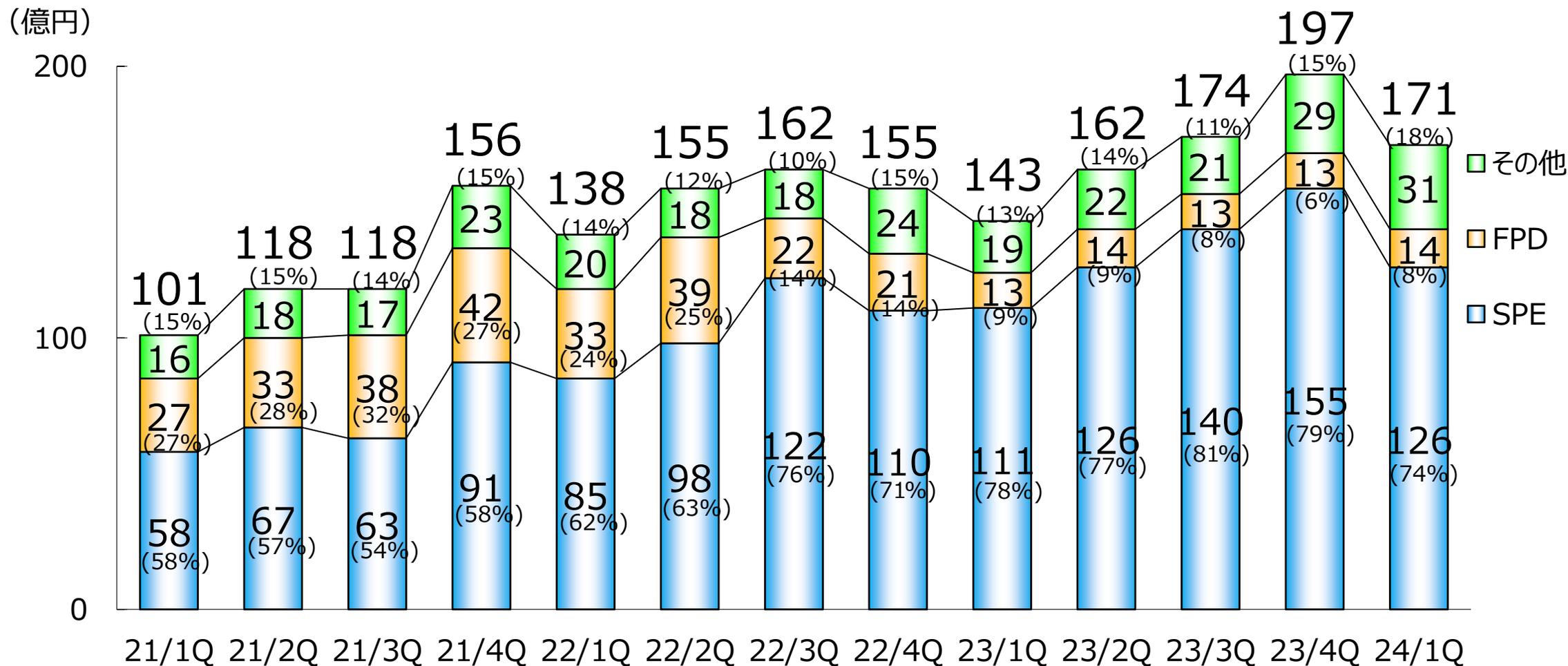
セグメント別売上高

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置
メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



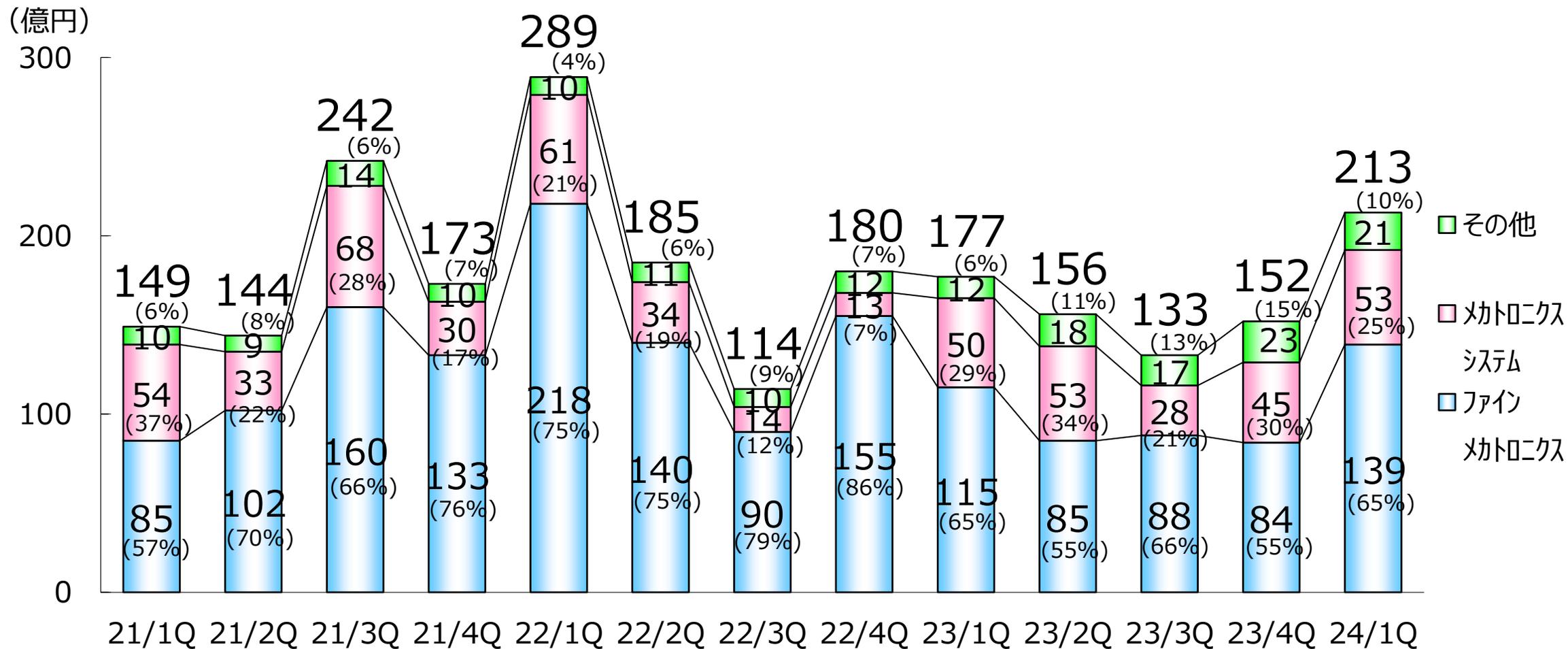
分野別売上高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置



セグメント別受注高

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置
 その他

